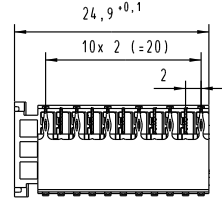
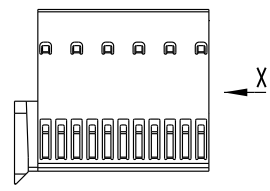
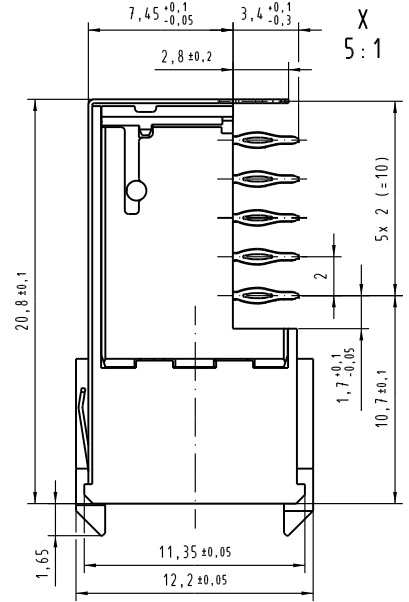
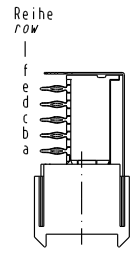
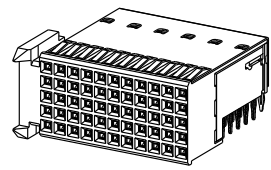
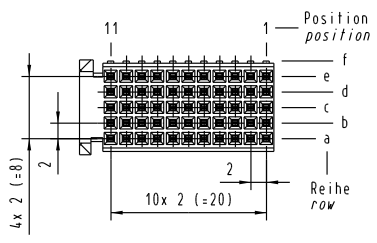
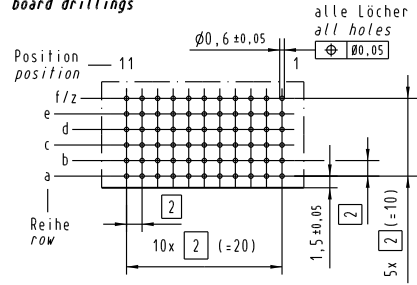


Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.



**Lochbild  
board drillings**



Bohrlochdurchmesser:  $\phi 0,7 \pm 0,02$  mm  
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche):  $\phi 0,6 \pm 0,05$  mm  
 drill hole dia.:  $\phi 0,7 \pm 0,02$  mm  
 through hole dia. (after plating):  $\phi 0,6 \pm 0,05$  mm

17 23 055 4102	-	min. $0,76 \mu\text{m}$ ( $30 \mu\text{in}$ ) Au über/over min. $1,27 \mu\text{m}$ ( $50 \mu\text{in}$ ) Ni
17 23 055 2102	2	Au über/over Ni
17 23 055 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3		Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size Tolerances IEC 61076-4-101	
Mod.	Dat.	Mod.	Dat.	Name	Maßstab/Scale	Sub.
32387	18.11.04	Hl.	29.06.99	Hm	2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste, Typ C, 55 pol. mit Schirmblech Reihe-f har-bus HM female connector, type C, 55 pol. with shield row-f
29412	07.05.01	Lk	29.06.99	Ko		
28494	20.09.00	Koe				
25016						
HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP						TB 17 23 055 x102
						Blatt/ page